

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 06/09/2024 | Edição: 173 | Seção: 1 | Página: 36

Órgão: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços/Secretaria de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços

CONSULTA PÚBLICA Nº 23, DE 5 DE SETEMBRO DE 2024

A Secretaria de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, de acordo com os artigos 8º e 9º da Portaria Interministerial SEPEC-ME/MCTIC nº 32, de 15 de julho de 2019, torna pública a proposta de alteração do Processo Produtivo Básico - PPB de MÁQUINA AUTOMÁTICA DIGITAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, COM TELA INCORPORADA - ALL IN ONE.

O texto completo está disponível no site da Secretaria, no endereço: <https://www.gov.br/mdic/pt-br/assuntos/competitividade-industrial/processo-produtivo-basico-ppb/consultas-publicas-de-ppb-1/consultas-publicas-de-ppb-2024>

As manifestações deverão ser encaminhadas no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data de publicação desta Consulta no Diário Oficial da União, a todos os seguintes e-mails: cgel.ppb@mdic.gov.br, cgia@mcti.gov.br, cgtd@mcti.gov.br e cgpri.ppb@suframa.gov.br.

UALLACE MOREIRA LIMA

Secretário

ANEXO

PROPOSTA Nº 014/24 - ALTERAÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO BÁSICO - PPB PARA O PRODUTO "MÁQUINA AUTOMÁTICA DIGITAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, COM TELA INCORPORADA - ALL IN ONE", ESTABELECIDO PELAS PORTARIAS INTERMINISTERIAIS SEPEC/ME/MCTIC NºS 23 E 25, DE 26 DE JUNHO DE 2019.

OBS.: A consulta está em forma de Portaria na versão da Lei de Informática, mas também vale para a versão da Zona Franca de Manaus.

Art. 1º O Processo Produtivo Básico para o produto MÁQUINA AUTOMÁTICA DIGITAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, COM TELA INCORPORADA - ALL IN ONE, industrializado no País, passa a ser composto pelas etapas e respectivas pontuações relacionadas na tabela constante do Anexo desta Portaria Interministerial.

§ 1º Os pontos totais serão atribuídos a cada etapa de produção realizada, conforme o disposto nos incisos do caput do art. 1º, sendo que a empresa deverá acumular no mínimo 562 (quinhentos e sessenta e dois) pontos por ano-calendário.

§ 2º O projeto de desenvolvimento a que se refere a etapa I do Anexo desta Portaria só será pontuado para o produto que atenda às especificações, normas e padrões adotados pela legislação brasileira e cujas especificações, projetos e desenvolvimentos tenham sido realizados no País, por técnicos de comprovado conhecimento em tais atividades, residentes e domiciliados no Brasil e atendam às Portarias específicas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.

Art. 2º O investimento em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Adicional (PD&IA) ao exigido pela legislação a que se refere a etapa II do Anexo desta Portaria deverá ser aplicado em programas e projetos de interesse nacional nas áreas de tecnologias da informação e comunicação considerados prioritários pelo Comitê da Área de Tecnologia da Informação - CATI.

§ 1º O investimento a que se refere o caput deste artigo deverá ser calculado sobre o faturamento bruto incentivado no mercado interno, decorrente da comercialização dos produtos a que se refere esta Portaria, nos termos dos §§1º e 2º do art. 9º do Decreto nº 10.356, de 20 de maio de 2020.

§ 2º A comprovação do investimento em PD&IA deverá ser apresentada de forma discriminada junto com o relatório descritivo referente à obrigação estabelecida na Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991.



§ 3º Para efeito do disposto no caput deste artigo, serão considerados como aplicação em atividades de PD&IA do ano-calendário os dispêndios correspondentes à execução de tais atividades realizadas até 31 de março do ano subsequente.

Art. 3º As empresas fabricantes deverão apresentar, quando aplicável, autorização do cedente da tecnologia quando da habilitação da empresa aos incentivos fiscais previstos na legislação.

Art. 4º Sempre que fatores técnicos ou econômicos, devidamente comprovados, assim o determinarem, a realização de qualquer etapa do Processo Produtivo Básico poderá ser suspensa temporariamente ou modificada por meio de portaria conjunta dos Ministérios do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e da Ciência, Tecnologia e Inovação.

Art. 5º Fica revogada a Portaria Interministerial SEPEC/ME/MCTIC nº 23, de 26 de junho de 2019.

Art. 6º Esta portaria entra em vigor em 1º de janeiro de 2025.

ANEXO

Etapa	Descrição da etapa produtiva	Pontos Totais
I	Projeto de Desenvolvimento no País - Portaria MCT nº 950, de 12 de dezembro de 2006, ou Portaria MCTIC nº 1.309, de 19 de dezembro de 2013, ou Portaria MCTIC nº 356, de 19 de janeiro de 2018, ou Portaria MCTIC nº 3.303, de 25 de junho de 2018, ou Portaria MCTI nº 4.514, de 2 de março de 2021.	80
II	Investimento em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Adicional (PD&IA), valendo 20 pontos para cada 10% investido, limitado a 60 pontos.	60
III	Desenvolvimento do software embarcado de baixo nível (firmware) da placa de circuito impresso responsável pelo processamento central.	20
IV	Corte dos wafers, encapsulamento e teste dos Processadores Principais (CPU).	132
V	Laminação e corte das placas de vidro e encapsulamento da célula de vidro polarizada.	107
VI	Injeção, moldagem ou outro processo de conformação (impressão 3D) ou estampagem da carcaça dos gabinetes.	59
VII	Trefilação e recozimento dos fios dos cabos de força.	30
VIII	Etchingoujet printing do circuito condutivo, encapsulamento da pastilha, soldagem e inicialização do circuito integrado na antena dos dispositivos de identificação por radiofrequência (RFID).	10
IX	Furação, transferência de imagem, corrosão, acabamento mecânico e teste elétrico da placa de circuito impresso que implemente a função de processamento central.	90
X	Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas que implementem a função de processamento central.	130
XI	Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas que implementem a função de interface de comunicação, quando não integradas à placa principal.	45
XII	Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso montadas com componentes elétricos ou eletrônicos que implementem a função de fonte de tensão, quando forem internas, e Conversores de Corrente Alternada/Corrente Contínua - CA/CC.	60
XIII	Corte do wafer e encapsulamento e teste dos circuitos integrados de memória volátil do tipo RAM.	150
XIV	Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas que implementem a função de memória volátil do tipo RAM, quando não integradas a outras placas de circuito impresso.	20
XV	Corte do wafer e encapsulamento e teste dos circuitos integrados de memória do tipo não-volátil do Solid State Drive(SSD) e on board.	143
XVI	Montagem e soldagem de todos os componentes do Solid State Drive (SSD).	20
XVII	Montagem e soldagem de todos os componentes na placa principal e montagem das partes e peças do mouse.	6
XVIII	Montagem e soldagem de todos os componentes na placa principal e montagem das partes e peças do teclado.	6
XIX	Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.	50
XX	Testes.	10
	Total	1.228
	Meta	562



Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

